

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 15 JAN 2004  
WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日  
Date of Application: 2003年 1月20日

出願番号  
Application Number: 特願 2003-011635  
[ST. 10/C]: [JP 2003-011635]

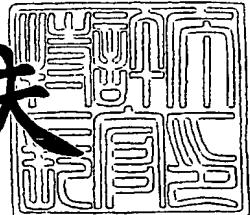
出願人  
Applicant(s): 株式会社フジクラ

PRIORITY  
DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年10月28日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願  
【整理番号】 20030021  
【特記事項】 特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願  
【提出日】 平成15年 1月20日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H05K 1/03  
【発明の名称】 多層配線板およびその製造方法  
【請求項の数】 19  
【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県佐倉市六崎1440 株式会社フジクラ 佐倉事業所内  
【氏名】 伊藤 彰二  
【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県佐倉市六崎1440 株式会社フジクラ 佐倉事業所内  
【氏名】 岸原 亮一  
【発明者】  
【住所又は居所】 千葉県佐倉市六崎1440 株式会社フジクラ 佐倉事業所内  
【氏名】 中尾 知  
【特許出願人】  
【識別番号】 000005186  
【氏名又は名称】 株式会社 フジクラ  
【代表者】 辻川 昭

**【代理人】**

【識別番号】 100083806

**【弁理士】**

【氏名又は名称】 三好 秀和

【電話番号】 03-3504-3075

**【選任した代理人】**

【識別番号】 100068342

**【弁理士】**

【氏名又は名称】 三好 保男

**【選任した代理人】**

【識別番号】 100100712

**【弁理士】**

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 幸邦

**【選任した代理人】**

【識別番号】 100100929

**【弁理士】**

【氏名又は名称】 川又 澄雄

**【選任した代理人】**

【識別番号】 100101247

**【弁理士】**

【氏名又は名称】 高橋 俊一

**【手数料の表示】**

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】 21,000円

**【提出物件の目録】**

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703890

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 多層配線板およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 マザーボードプリント配線板に、予め外形加工がなされた少なくとも 1 枚の配線回路付き基材が貼り合わせされており、それらが少なくとも 1 箇所でインナビアホールによって電気的に接続されている多層配線板。

【請求項 2】 前記配線回路付き基材の外形が前記マザーボードプリント配線板の外形より小さく、前記配線回路付き基材が前記マザーボードプリント配線板上で島状をなしている請求項 1 記載の多層配線板。

【請求項 3】 外形加工済みの複数枚の配線回路付き基材が積層されている請求項 1 または 2 記載の多層配線板。

【請求項 4】 前記配線回路付き基材は、絶縁層の片面に配線回路が形成された片面配線回路付き基材である請求項 1 ~ 3 の何れか 1 項記載の多層配線板。

【請求項 5】 前記マザーボードプリント配線板の絶縁層がポリイミド等の可撓性樹脂により構成されている請求項 1 ~ 4 の何れか 1 項記載の多層配線板。

【請求項 6】 前記配線回路付き基材の絶縁層がポリイミド等の可撓性樹脂により構成されている請求項 1 ~ 5 の何れか 1 項記載の多層配線板。

【請求項 7】 前記マザーボードプリント配線板の絶縁層と前記配線回路付き基材の絶縁層とが同じ材料によって構成されている請求項 1 ~ 6 の何れか 1 項記載の多層配線板。

【請求項 8】 前記マザーボードプリント配線板及び前記配線回路付き基材を被覆するカバー層が形成されている請求項 1 ~ 7 の何れか 1 項記載の多層配線板。

【請求項 9】 前記マザーボードプリント配線板に、前記配線回路付き基材の配置部位を開口させたカバー層が形成されている請求項 1 ~ 7 の何れか 1 項記載の多層配線板。

【請求項 10】 前記カバー層の開口において前記カバー層と前記配線回路付き基材との隙間に露呈する前記マザーボードプリント配線板の配線回路が当該配線回路より貴なる金属によって被覆されている請求項 9 記載の多層配線板。

【請求項11】 前記カバー層の開口において前記カバー層と前記配線回路付き基材との隙間に露呈する前記マザーボードプリント配線板の表面を被覆する追加のカバー層が形成されている請求項9記載の多層配線板。

【請求項12】 前記配線回路付き基材のうち、前記マザーボードプリント配線板と接触する配線回路付き基材の絶縁層が前記マザーボードプリント配線板を被覆するカバー層を兼ねている請求項1～7の何れか1項記載の多層配線板。

【請求項13】 前記配線回路付き基材のインナビアホールには層間導通のための導電性ペーストが充填されている請求項1～12記載の多層配線板。

【請求項14】 前記配線回路付き基材の導電層に前記インナビアホールと連通する小孔があけられている請求項13記載の多層配線板。

【請求項15】 マザーボードプリント配線板の表面あるいは／および裏面に、外形加工済みの配線回路付き基材を貼り合わせる工程を含む多層配線板の製造方法。

【請求項16】 マザーボードプリント配線板の表面あるいは／および裏面に、配線回路形成、バイアホール形成および外形加工済みの配線回路付き基材を貼り合わせる工程を含む多層配線板の製造方法。

【請求項17】 前記配線回路付き基材は前記マザーボードプリント配線板の外形より小さい外形に外形加工されている請求項15または16記載の多層配線板の製造方法。

【請求項18】 前記配線回路付き基材をマザーボードプリント配線板に貼り合わせる工程の前に、マザーボードプリント配線板に、前記配線回路付き基材の貼り合わせ部位を開口させたカバー層を形成する工程を含む請求項15～17の何れか1項記載の多層配線板の製造方法。

【請求項19】 前記配線回路付き基材をマザーボードプリント配線板に貼り合わせる工程の後に、前記マザーボードプリント配線板および前記配線回路付き基材を被覆するカバー層を形成する工程を含む請求項15～18の何れか1項記載の多層配線板の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【0001】

**【発明の属する技術分野】**

この発明は、多層配線板およびその製造方法に関し、特に、多層フレキシブルプリント配線板に関するものである。

**【0002】****【従来の技術】**

近年の電子機器は、高周波信号、デジタル化等に加え、小型、軽量化が進み、それに伴い、搭載されるプリント配線板においても、小型、高密度実装化等が要求される。これらの要求に応えるプリント配線板として、リジッド部とフレックス部とを含むリジッドフレックスプリント配線板がある（特許文献1）。

**【0003】**

リジッドフレックスプリント配線板の代表的な製造プロセスを、図13（a）～（c）を参照して説明する。

**【0004】**

図13（a）に示されているように、ポリイミドフィルム等によるフレックス基板101の両面と、プリプレグ等による内層リジッド基板102の両面および外層リジット基板103の片面にそれぞれ配線回路104をサブトラクティブ法によって形成する。

**【0005】**

ついで、接着シート105および内層リジット基板102、外層リジット基板103にプレス打ち抜き等によってフレックス部露出穴109を設ける。ついで、フレックス基板用カバーレイヤ106、内層リジッド基板102、接着シート105、外層リジット基板103を、フレックス基板101の表裏に重ねて配置し、積層加工によって図13（b）に示されている積層体100を得る。

**【0006】**

ついで、積層体100に、ドリル孔あけ加工、めっき処理、エッチング等を施し、スルーホール107、外層配線回路108等を形成し、最後に、リジッド部分Bとフレックス部分Aの外形を同時に抜くことで、図13（c）に示されているようなリジッドフレックスプリント配線板110を得る。

**【0007】**

また、リジットフレックスプリント配線板の表層にビルドアップ層を設け、I VH (interstitial Via Hole) や SVH (Surface Via Hole) によって層間接続をするものも発表されている。

### 【0008】

#### 【特許文献】

特開2002-158445号公報

### 【0009】

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このようなリジッドフレックスプリント配線板の場合、リジッド部の積層後に、リジッド部とフレックス部の外形を同時に抜くことが行われるから、リジッド部の形状（領域）は、フレックス基板とその表裏に積層されている内層リジット基板、外層リジット基板を含む多層部と同じになる。

### 【0010】

このため、リジッド部に余分な多層化領域が存在することが生じ、材料コストに無駄が生じる。また、多層領域の位置に制限が設けられ、配線の自由度を損なうことになる。にもかかわらず、電子部品実装用の多層化部（リジッド部）とフレックス基板の接続技術としては、リジッドフレックスプリント配線板が、配線の自由度、基板面積という点で最良であるのが現状である。

### 【0011】

この発明は、上述の如き問題点を解消するためになされたもので、より高い配線自由度をえることができ、材料コストの削減、基板容量の縮小を達成する多層配線板およびその製造方法を提供することを目的としている。

### 【0012】

#### 【課題を解決するための手段】

上述の目的を達成するために、この発明による多層配線板は、マザーボードプリント配線板に、予め外形加工がなされた少なくとも1枚の配線回路付き基材が貼り合わせされており、それらが少なくとも1箇所でインナビアホールによって電気的に接続されている。

### 【0013】

のことにより、配線回路付き基材の外形を前記マザーボードプリント配線板の外形に合わせる必要がなく、配線回路付き基材の外形を前記マザーボードプリント配線板の外形より小さく設定でき、配線回路付き基材がマザーボードプリント配線板上で必要部位を選んだ島状をなしている構造にすることができる。

#### 【0014】

また、外形加工済みの配線回路付き基材を複数枚の積層することができ、マザーボードプリント配線板上で必要部位を選んで最小必要限度の領域を多層化することができる。この外形加工済みの配線回路付き基材は、絶縁層の片面に配線回路が形成された片面配線回路付き基材であってよい。

#### 【0015】

また、前記マザーボードプリント配線板の絶縁層や前記配線回路付き基材の絶縁層はポリイミド等の可撓性樹脂により構成することができ、全体を、あるいは部分的にフレキシブルプリント配線板とすることができる。また、マザーボードプリント配線板の絶縁層と配線回路付き基材の絶縁層は、熱的、機械的影響の観点等から、同じ材料によって構成されていることが好ましい。

#### 【0016】

また、この発明による多層配線板は、導電層の保護のために、前記マザーボードプリント配線板及び前記配線回路付き基材を被覆するカバー層が形成されているか、前記配線回路付き基材の配置部位を開口させたカバー層が形成されている。そして、前記カバー層の開口において前記カバー層と前記配線回路付き基材との隙間に露呈する前記マザーボードプリント配線板の配線回路が当該配線回路より貴なる金属によって被覆されている、あるいは前記カバー層の開口において前記カバー層と前記配線回路付き基材との隙間に露呈する前記マザーボードプリント配線板の表面を被覆する追加のカバー層が形成されている。

#### 【0017】

また、この発明による多層配線板は、前記配線回路付き基材のうち、前記マザーボードプリント配線板と接触する配線回路付き基材の絶縁層が前記マザーボードプリント配線板を被覆するカバー層を兼ねている。

#### 【0018】

また、この発明による多層配線板は、前記配線回路付き基材のインナビアホールには層間導通のための導電性ペーストが充填されており、更には、前記配線回路付き基材の導電層に導電性ペースト充填時の空気抜き孔として作用する小孔があけられている。

#### 【0019】

また、上述の目的を達成するために、この発明による多層配線板の製造方法は、マザーボードプリント配線板の表面あるいは／および裏面に、外形加工済みの配線回路付き基材を貼り合わせる工程を含む。さらには、マザーボードプリント配線板の表面あるいは／および裏面に、配線回路形成、バイアホール形成および外形加工済みの配線回路付き基材を貼り合わせる工程を含む。

#### 【0020】

この多層配線板の製造方法では、配線回路付き基材の外形を前記マザーボードプリント配線板の外形に合わせる必要がなく、配線回路付き基材の外形を前記マザーボードプリント配線板の外形より小さく設定でき、配線回路付き基材がマザーボードプリント配線板上で必要部位を選んだ島状をなしている構造にすることができる。

#### 【0021】

また、この多層配線板の製造方法は、前記配線回路付き基材をマザーボードプリント配線板に貼り合わせる工程の前に、マザーボードプリント配線板に、前記配線回路付き基材の貼り合わせ部位を開口させたカバー層を形成する工程を含む。

#### 【0022】

また、この多層配線板の製造方法は、前記配線回路付き基材をマザーボードプリント配線板に貼り合わせる工程の後に、前記マザーボードプリント配線板および前記配線回路付き基材を被覆するカバー層を形成する工程を含む。

#### 【0023】

##### 【発明の実施の形態】

以下に添付の図を参照してこの発明の実施形態を詳細に説明する。

図1、図2はこの発明による多層配線板の基本的な実施形態を示している。本

実施形態の多層配線板は、マザーボードプリント配線板（ベース基板）10の表裏の複数箇所に、各々、予め外形加工をなされた部分的配線基板（多層化部分）20が島状に貼り合わせされている。部分的配線基板20は、予め、マザーボードプリント配線板10の外形よりも小さい所定形状に外形加工された複数枚の片面配線回路付き樹脂基材21をマザーボードプリント配線板10の表裏に一括積層したものである。なお、部分的配線基板20は、両面配線回路付き樹脂基材を含んで多層化することもできる。

#### 【0024】

マザーボードプリント配線板10は、絶縁基材11の表裏両面に導体層（配線回路）12を有する。マザーボードプリント配線板10の絶縁基材11はポリイミド等の可撓性樹脂により構成することができる。片面配線回路付き樹脂基材21は、絶縁基材22の片面に導体層（配線回路）23を有する。片面配線回路付き樹脂基材21の絶縁基材22も、リジッドなプリプレグ以外に、ポリイミド等の可撓性樹脂により構成することができる。

#### 【0025】

多層化された片面配線回路付き樹脂基材21の導体層23同士と、片面配線回路付き樹脂基材21の導体層23とマザーボードプリント配線板10の導体層12とが、各々片面配線回路付き樹脂基材21に形成されたインナビアホール（バイアホール）24の導電性ペースト等による導体25によって電気的に接続されている。

#### 【0026】

具体的な製造方法としては、マザーボードプリント配線板10の表面あるいは／および裏面の一部に、外形加工済みである片面配線回路付き樹脂基材21を貼り合わせる工程を含むものである。これは、もちろん、片面配線回路付き樹脂基材21を一枚づつ貼り合わせていくビルトアップ法でも構わないが、より簡略な製造工程とし、製造コストの削減を図る場合には、マザーボードプリント配線板10の表面あるいは／および裏面の一部に、配線回路形成、バイアホール形成および外形加工済みである片面配線回路付き樹脂基材21を、複数枚重ね、一括で加熱加圧することで貼り合わせる一括積層法が適用される。

**【0027】**

片面配線回路付き樹脂基材21同士の接着と、片面配線回路付き樹脂基材21とマザーボードプリント配線板10との接着は、片面配線回路付き樹脂基材21の絶縁基材22の導体層23とは反対側の面に接着層（図示省略）を形成し、この接着層によって行うことができる。片面配線回路付き樹脂基材21の絶縁基材22が、熱可塑性ポリイミド、あるいは熱可塑性ポリイミドに熱硬化機能を付与したもの、あるいは液晶ポリマ等、それ自身、接着性を有するものであれば、上述の接着層を省略することができる。

**【0028】**

これらによれば、マザーボードプリント配線板10の表面の自由な位置に電子部品実装用の多層化部（部分的配線基板20）を自由に配置でき、しかも、余計な多層化部を削減でき、材料費を大きく削減できる。

**【0029】**

リジッドフレックスプリント配線板のように、ポリイミド等の可撓性樹脂基板によるフレックス部とリジットな多層部が混在するような場合でも、上述のマザーボードプリント配線板10をフレックス基板として、上記課題が解決される。特に、誘電特性、軽薄、といった要求により、電子部品実装部分がポリイミドのような高価な材料で構成される場合には、この効果は極めて大きいといえる。

**【0030】**

また、このような基板構成の場合、電子部品実装部である部分的配線基板20の絶縁層（絶縁基材22）とフレックス部（マザーボードプリント配線板10）の絶縁層（絶縁基材11）を同じ材料とし、両者の熱的、機械的特性を合わせることで、高い熱的、機械的信頼性を得ることができる。

**【0031】**

マザーボードプリント配線板10には、導電層の保護を目的としてカバーレイヤやソルダーレジスト等のカバー層が設けられるのが一般的である。マザーボードプリント配線板10のカバー層は、片面配線回路付き樹脂基材21によって多層化される部分を予め開口しておき、開口部に片面配線回路付き樹脂基材21を

貼り合わせてよい。この場合には、図3に示されているように、開口部13Aにおいて、多層化されている部分（部分的配線基板20の配置部）とカバー層13との間に隙間gができ、隙間g部分では導電層12がむき出し（外部露呈）になってしまう。

#### 【0032】

従って、この場合には、むき出しになっている部分を、図4に示されているように、金など、導電層12よりも貴なる貴金属15によって被覆し、酸化を防止するか、あるいは図5に示されているように、ソルダーレジスト等によるカバー層16によって被覆することが好ましい。

#### 【0033】

また、カバー層16は、図6に示されているように、多層化部分の貼り合わせ後に、マザーボードプリント配線板10と多層化された部分の一部を被覆するように形成することにより、たとえばマザーボード配線板10がフレックスである場合の屈曲時に、多層化部分と屈曲部の界面での剥がれといった問題を防ぐことができる。

#### 【0034】

また、工程の簡略化を図りたい場合には、図7に示すごとく、マザーボードプリント配線板10のカバーレイヤと、マザーボードプリント配線板10に接触して直上に貼り合わせられた片面配線回路付き樹脂基材21の絶縁層とが一体成形されている構造とすることで解決される。より具体的には、片面配線回路付き樹脂基材21の絶縁層とマザーボードプリント配線板20のカバーレイヤとを同一の絶縁層17から形成し、これをマザーボードプリント配線板10に貼り合わせる工程を含むものである。

#### 【0035】

また、図8に示されているように、これらの構造のインナビアホール24を、導電性ペーストインナーホールとし、片面配線回路付き樹脂基材21の導電層23部分に樹脂基板部分の口径よりも小さい空気抜き用の小孔27を貫通形成することで、導電性ペースト充填時のボイド残りを防止することができる。導電性ペーストは、小孔27が空洞とならないよう、小孔27にも充填されている。なお

、図8において、符合26は層間接着層を示している。

### 【0036】

つぎに、この発明による一実施形態に係わる多層配線板で使用する片面配線回路付き樹脂基材の製造方法を図9（a）～（f）を参照して説明する。

### 【0037】

図9（a）に示されているような、ポリイミド基材51の片面に銅箔52を有する片面銅箔付きポリイミド基材50を出発材料とし、サブトラクティブ法によって、銅箔52をエッチングすることで、図9（b）に示されているような回路形成済み基材53を得た。これは、もちろん、銅箔のないポリイミド基材を出発材料として、アディティブ法、セミアディティブ法によっても得ることができる。

### 【0038】

ついで、図9（c）に示されているように、回路形成済み基材53の銅箔52とは反対側の面に層間接着層54を形成する。層間接着層54としては、熱可塑性ポリイミドに熱硬化機能を付与したものを使用したが、これは、もちろん、エポキシ等に代表される熱硬化性の樹脂や、熱可塑性ポリイミド等の熱可塑性樹脂でも構わない。

### 【0039】

ただし、銅箔52とポリイミド基材51と層間接着層54の3層構成は、表裏非対称なものであり、接着層を形成した状態で後の工程で、不具合となるような反りが発生しないことが好ましい。層間接着層54は、ガラス転移温度が110°C以下、常温弾性率が1300 MPa以下であることが好ましい。

### 【0040】

ついで、図9（d）に示されているように、層間接着層54およびポリイミド基材51を貫通するよう、UV-YAGレーザによって穴開け加工（バイアホール加工）を施した後、プラズマ照射によるソフトエッチを施すことでデスマニアを行い、この穴55に穴埋用銀ペースト56を充填することでIVHを形成した。

### 【0041】

レーザは、もちろん、UV-YAGレーザのほかにも、炭酸ガスレーザやエキ

シマレーザー等によって、現状では、より高速で加工ができる。また、デスマニアの方法として、過マンガン酸塩を使用した湿式デスマニアも、ごく一般的である。

I V H充填の導電性ペーストとしては、銀ペーストのほかにも、銅ペースト、カーボンペースト、ニッケルペースト等、種々の金属ペーストを使用することが可能である。

#### 【0042】

ついで、図9（e）に示されているように、点線Lで示されている如く、外形加工することを目的とし、金型でプレスすることで、所望の大きさに外形加工を施し、図9（f）に示されている片面配線回路付き樹脂基材57を得た。この際、導電性ペースト56によるI V Hが破壊されることを防ぐために、接触しても破壊が起きない程度に導電性ペースト56を仮硬化させておく必要がある。具体的には、鉛筆硬度で2B以上硬化していることが好ましい。

#### 【0043】

つぎに、この発明による一実施形態に係わる多層配線板の製造方法を図10（a）～（c）を参照して説明する。

#### 【0044】

図10（a）に示されているように、配線回路61が形成済みで、かつ、積層予定部分を開口（開口部62A）させたカバーレイヤ62が表面に形成されているマザーボードFPC60の開口部62Aに、外形加工済みの片面配線回路付き樹脂基材57を、2層、位置合わせを施した後に重ね合わせ、真空熱プレス機により、真空度1kPa以下の下で加熱・加圧し、図10（b）に示されているような多層化部分64を含む基板63を得た。

#### 【0045】

位置合わせには、ピンアライメント方式をとっても構わないが、ピン用の穴を開けるスペースが必要になるため、好ましいとは言えない。従って、画像認識による位置合わせを実施した。

#### 【0046】

ついで、図10（c）に示されているように、基板63上、マザーボードFPC60のカバーレイヤ62と多層化部分64の隙間、および多層化部分64の表

面の一部およびカバーレイヤ62の表面の一部を被覆するよう、印刷法によってソルダーレジスト65を塗布し、硬化させることで、多層配線板66を得た。

#### 【0047】

つぎに、この発明による他の実施形態に係わる多層配線板の製造方法を図11(a)、(b)を参照して説明する。なお、図11において、図10に対応する部分は、図10に付した符号と同一の符号を付けて、その説明を省略する。

#### 【0048】

図11(a)に示されているように、配線回路61が形成済みのマザーボードFPC60に、上述の実施形態(図9)と同様の方法で製造した片面配線回路付き樹脂基材57、70を、2層、位置合わせを施した後に重ね合わせる。マザーボードFPC60の回路面に接触する片面配線回路付き樹脂基材70は、その絶縁層(ポリイミド基材51)によってマザーボードFPC60の銅箔部分等、カバーレイヤによって被覆すべき部分を被覆する外径形状になっており、基板70の絶縁層がカバーレイヤを兼ねている。

#### 【0049】

この位置合わせも、ピンアライメント方式をとっても構わないが、ピン用の穴を開けるスペースが必要になるため、好ましいとは言えない。従って、画像認識による位置合わせを実施した。

#### 【0050】

位置合わせ後に、真空熱プレス機により、真空度1kPa以下の下で加熱・加圧し、図11(b)に示されている基板71を得た。この方法によると、熱プレス時に、片面配線回路付き樹脂基材57と70とで段差ができるから、この段差を埋め合わせるクッション構成とすることが好ましい。

#### 【0051】

つぎに、この発明によるもう一つの実施形態に係わる多層配線板の製造方法を図12(a)～(e)を参照して説明する。なお、図12においても、図10に対応する部分は、図10に付した符号と同一の符号を付けて、その説明を省略する。

#### 【0052】

図12 (a) に示されているように、配線回路61が形成済みで、かつ、積層予定部分を開口（開口部62Aと62B）させたカバーレイヤ62が表面に形成されているマザーボードFPC60の開口部62Aに、外形加工済みの片面配線回路付き樹脂基材57を、2層、位置合わせを施した後に重ね合わせ、真空熱プレス機により、真空度1kPa以下の下で加熱・加圧し、図12 (b) に示されているような多層化部分64を得た。

#### 【0053】

ついで、図12 (c) に示されているように、マザーボードFPC60のもう一方の開口部62Bに、外形加工済みの片面配線回路付き樹脂基材57を、3層、位置合わせを施した後に重ね合わせ、真空熱プレス機により、真空度1kPa以下の下で加熱・加圧し、図12 (d) に示されているような多層化部分67を得た。

#### 【0054】

ついで、図12 (e) に示されているように、マザーボードFPC60のカバーレイヤ62と多層化部分64、67の隙間、および多層化部分64、67の表面の一部およびカバーレイヤ62の表面の一部を被覆するよう、印刷法によってソルダーレジスト65を塗布し、硬化させることで、多層配線板68を得た。

#### 【0055】

このようにして、多層部分間で層数が違う、即ち、厚さが違う場合でも、多層構造を得る事ができる。

#### 【0056】

##### 【発明の効果】

以上の説明から理解される如く、この発明による多層配線板およびその製造方法によれば、マザーボードプリント配線板に、予め外形加工がなされた少なくとも1枚の配線回路付き基材が貼り合わせされ、それらが少なくとも1箇所でインナビアホールによって電気的に接続されている。配線回路付き基材の外形はマザーボードプリント配線板の外形より小さく、配線回路付き基材がマザーボードプリント配線板上で島状をなしているから、より高い配線自由度をえることができ、材料コストの削減、基板容量の縮小を達成することができる。

**【図面の簡単な説明】****【図 1】**

この発明による多層配線板の一つの実施形態を示す断面図である。

**【図 2】**

この発明による多層配線板の一つの実施形態を示す平面図である。

**【図 3】**

この発明による多層配線板の他の実施形態を示す断面図である。

**【図 4】**

この発明による多層配線板の他の実施形態を示す断面図である。

**【図 5】**

この発明による多層配線板の他の実施形態を示す断面図である。

**【図 6】**

この発明による多層配線板の他の実施形態を示す断面図である。

**【図 7】**

この発明による多層配線板の他の実施形態を示す断面図である。

**【図 8】**

この発明による多層配線板の他の実施形態を示す断面図である。

**【図 9】**

(a) ~ (f) はこの発明による一実施形態に係わる多層配線板で使用する片面配線回路付き樹脂基材の製造方法を示す工程図である。

**【図 10】**

(a) ~ (c) はこの発明による一実施形態に係わる多層配線板の製造方法を示す工程図である。

**【図 11】**

(a) 、 (b) はこの発明による他の実施形態に係わる多層配線板の製造方法を示す工程図である。

**【図 12】**

(a) ~ (e) はこの発明による他の実施形態に係わる多層配線板の製造方法を示す工程図である。

**【図13】**

a)～(c)はリジッドフレックスプリント配線板の代表的な製造プロセスを示す工程図である。

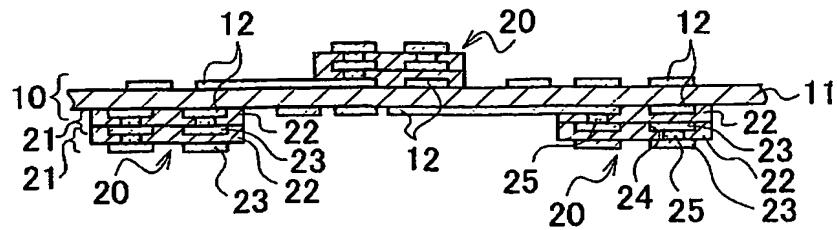
**【符号の説明】**

- 1 0 マザーボードプリント配線板
- 1 1 絶縁基材
- 1 2 導体層
- 1 3 カバー層
- 1 5 貴金属
- 1 6 カバー層
- 1 7 絶縁層
- 2 0 部分的配線基板
- 2 1 片面配線回路付き樹脂基材
- 2 2 絶縁基材
- 2 3 導体層
- 2 4 インナビアホール
- 2 5 導体
- 2 7 小孔
- 2 6 層間接着層
- 5 0 片面銅箔付きポリイミド基材
- 5 1 ポリイミド基材
- 5 2 銅箔
- 5 3 回路形成済み基材
- 5 4 層間接着層
- 5 5 穴
- 5 6 導電性ペースト
- 5 7 片面配線回路付き樹脂基材
- 6 0 マザーボードFPC
- 6 1 配線回路

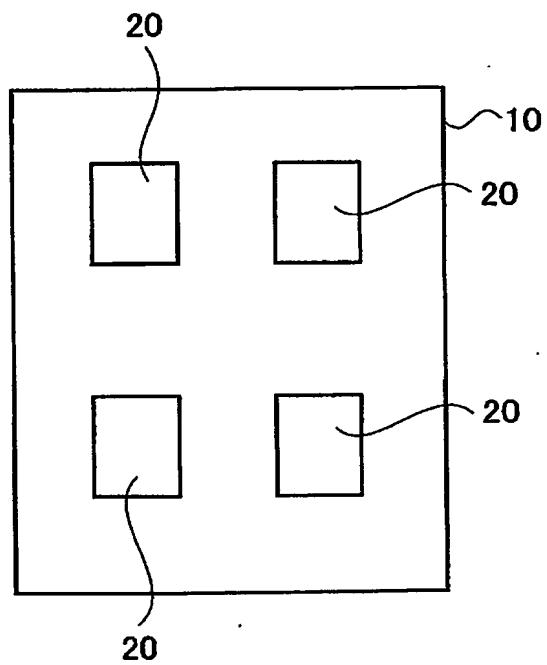
- 6 2 カバーレイヤ
- 6 3 基板
- 6 4 多層化部分
- 6 5 ソルダーレジスト
- 6 6 多層配線板
- 6 7 多層化部分
- 6 8 多層配線板
- 7 0 片面配線回路付き樹脂基材
- 7 1 多層配線板

【書類名】 図面

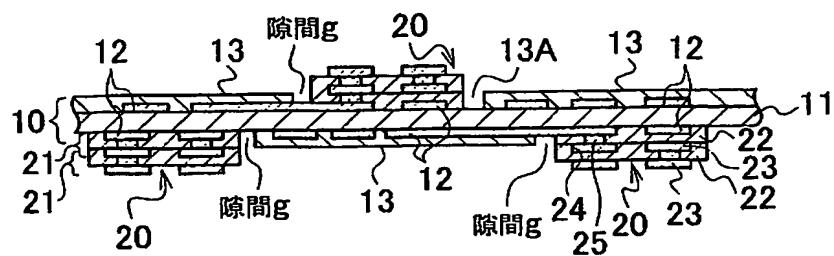
【図 1】



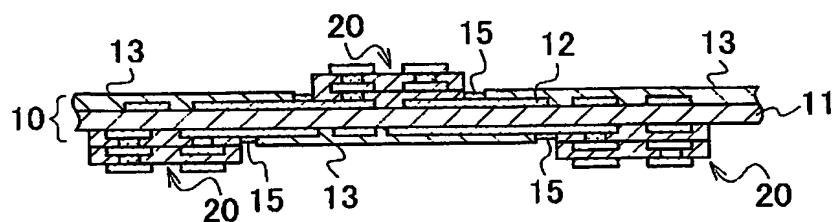
【図 2】



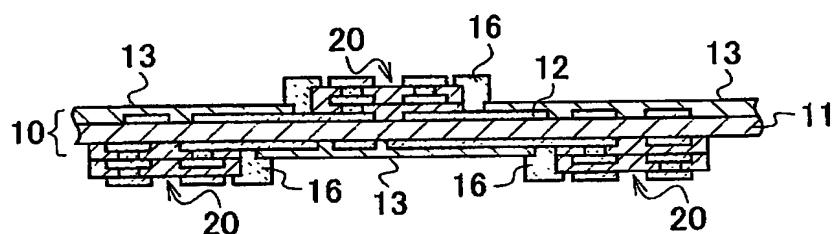
【図3】



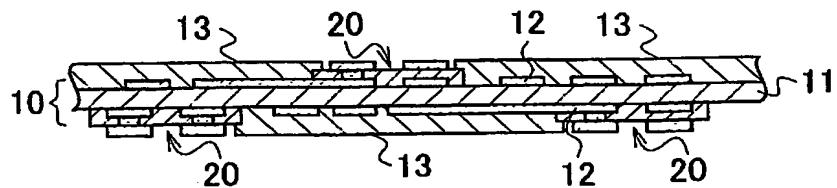
【図4】



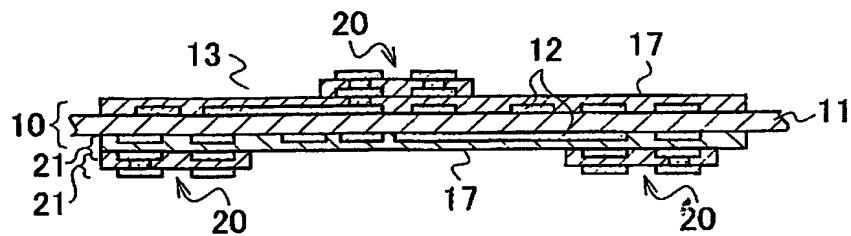
【図5】



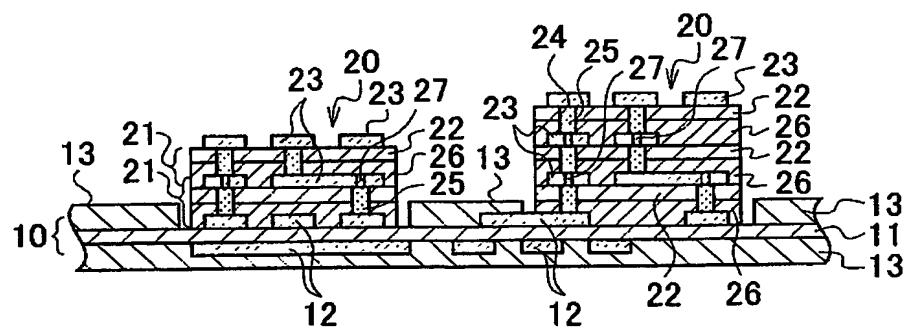
【図6】



【図7】

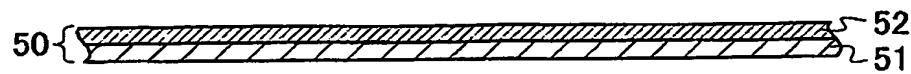


【図8】



【図 9】

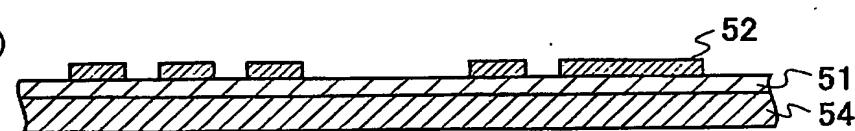
( a )



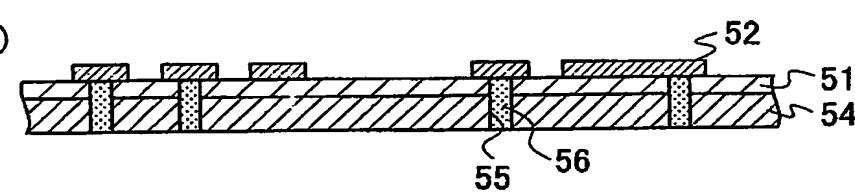
( b )



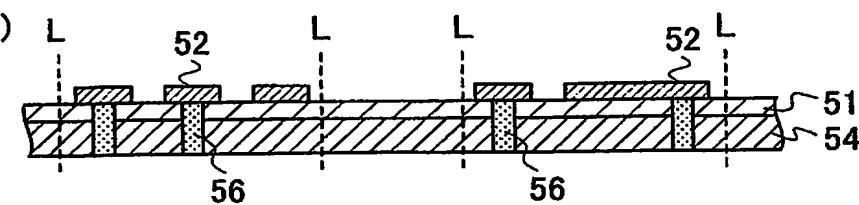
( c )



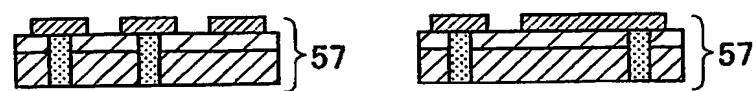
( d )



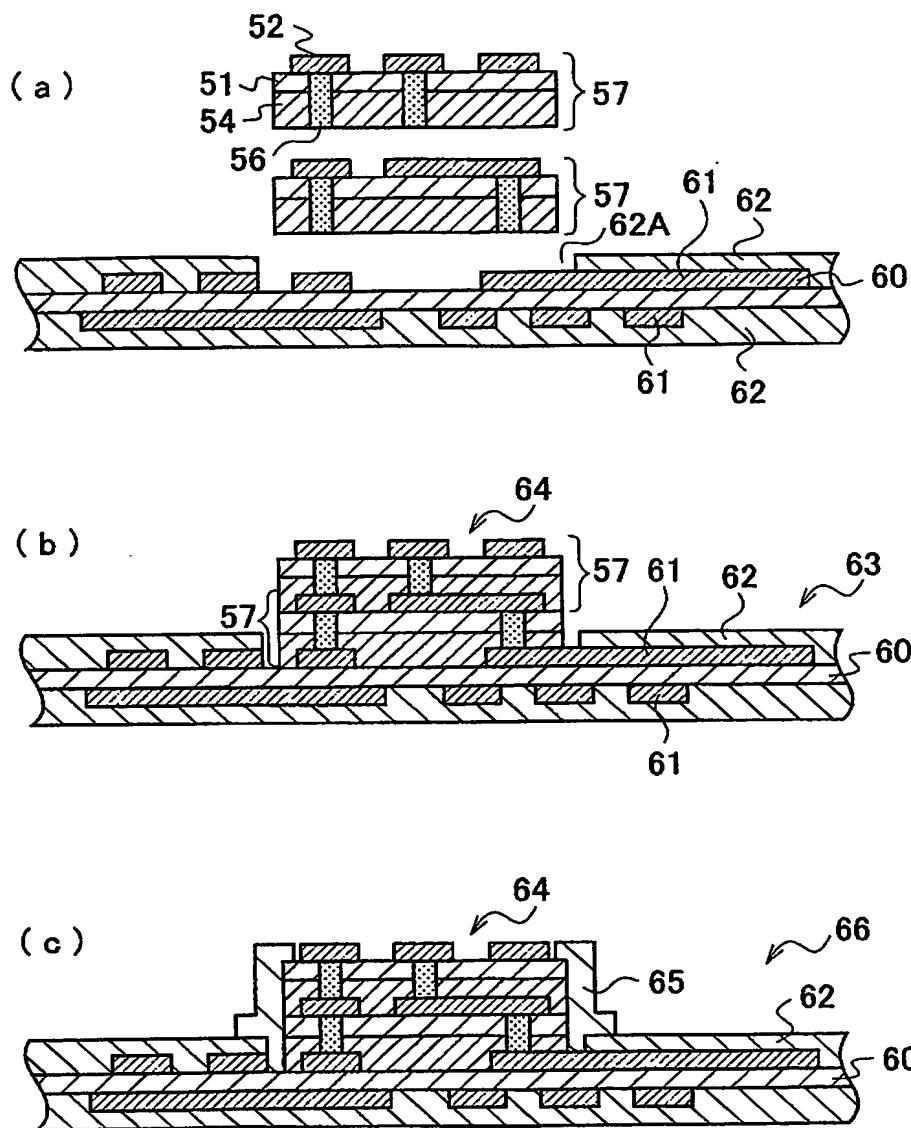
( e )



( f )

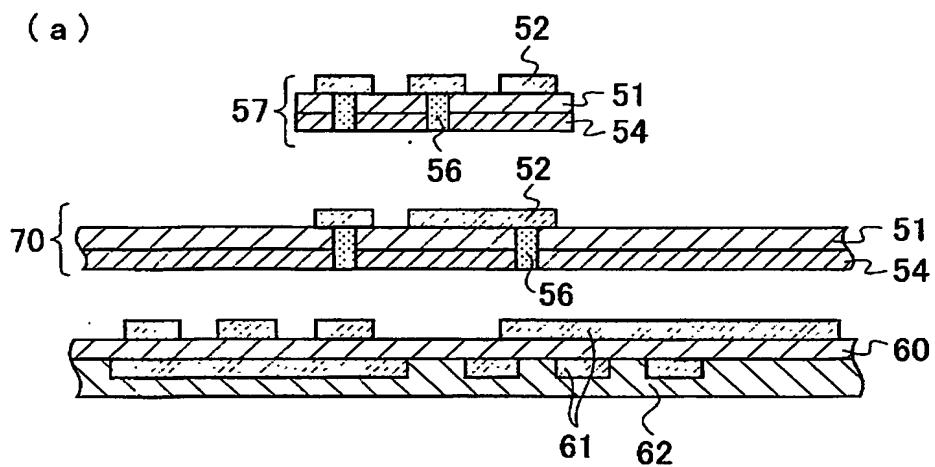


【図10】

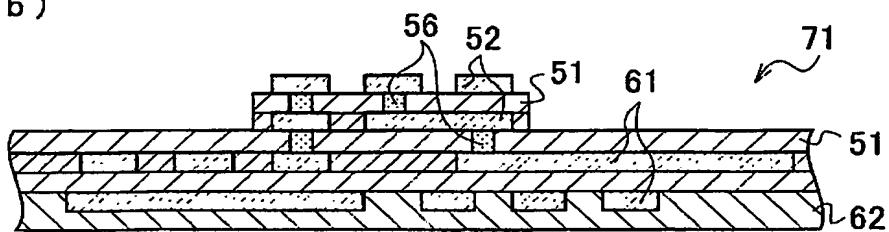


【図11】

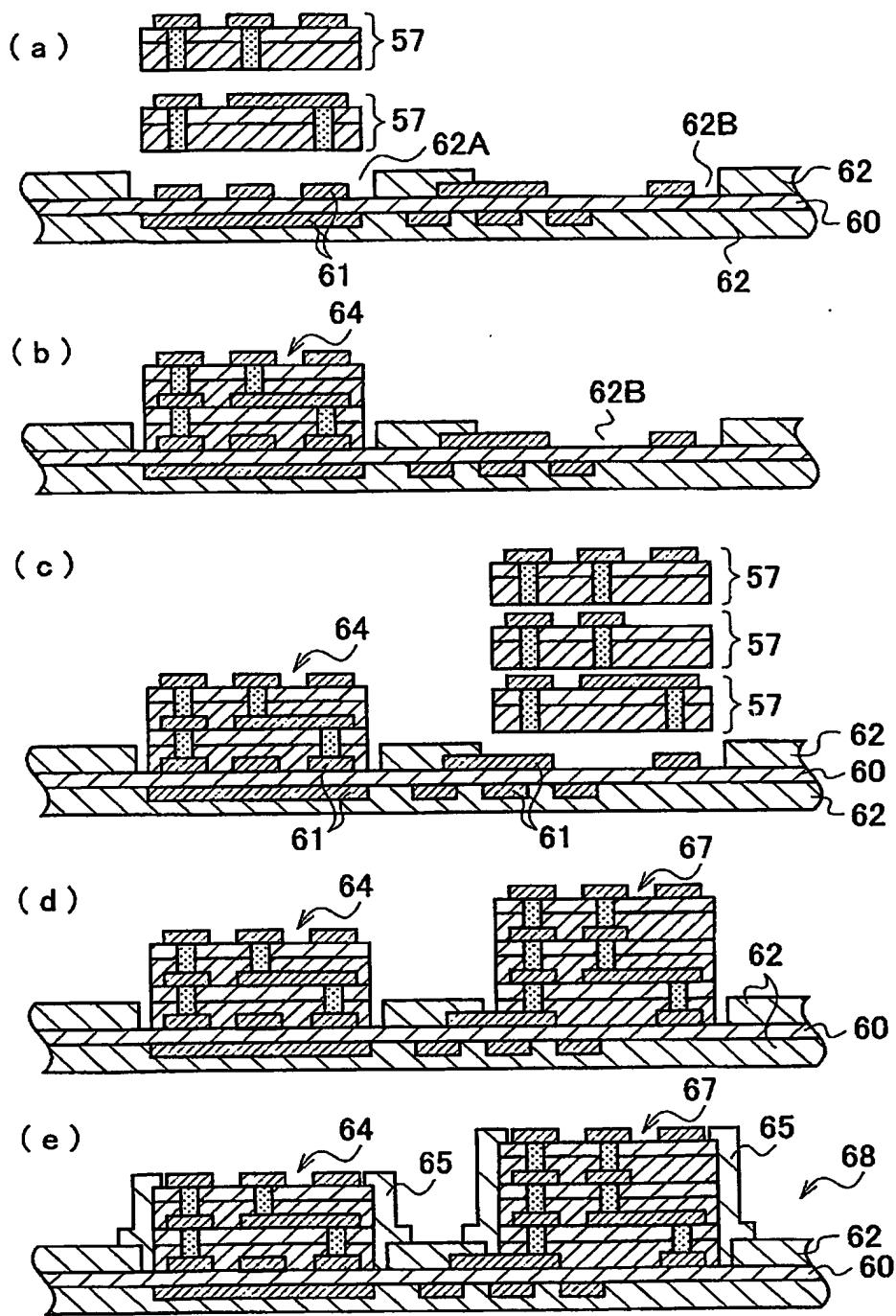
(a)



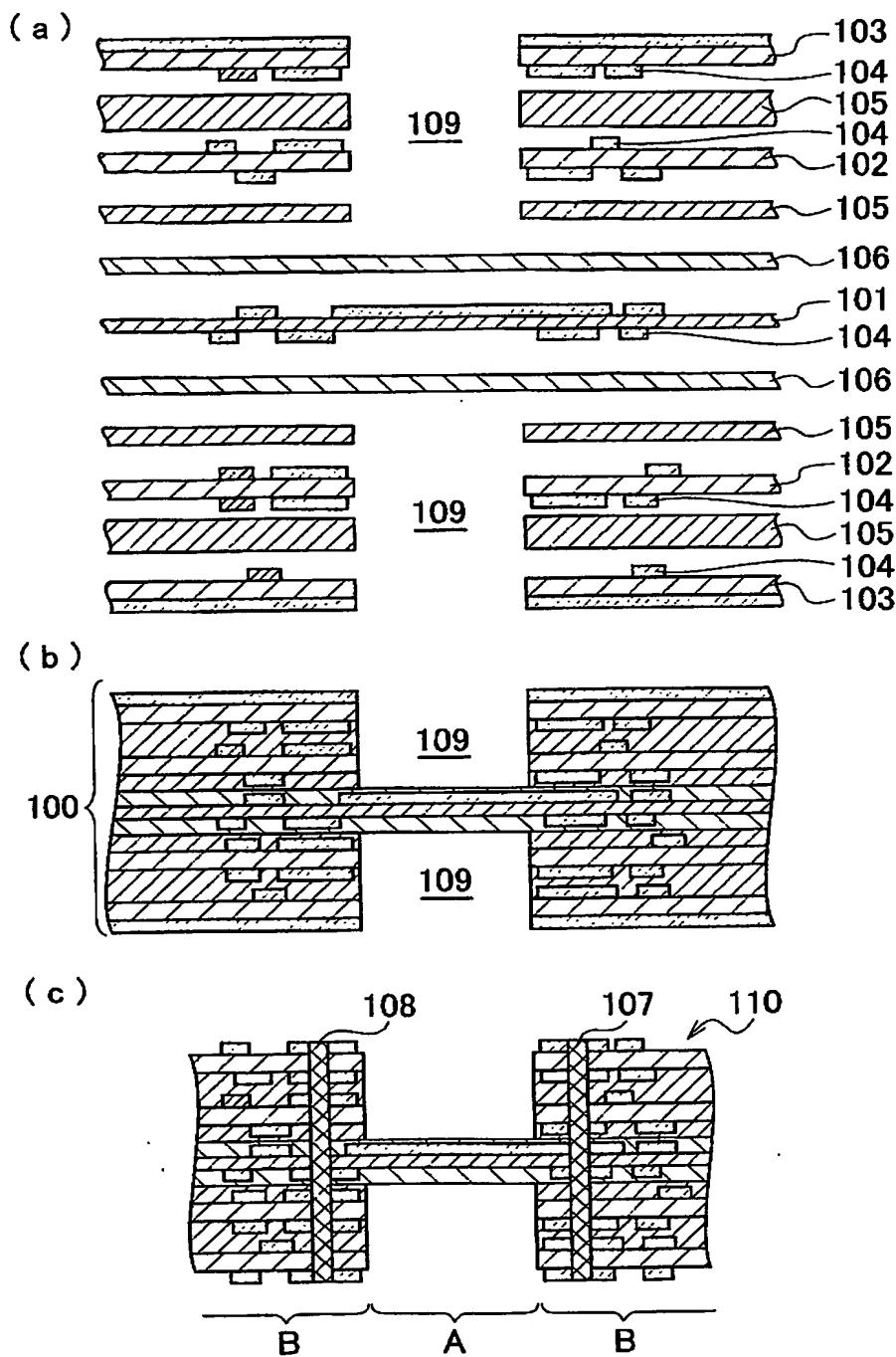
(b)



【図12】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 多層配線板において、より高い配線自由度をえることができ、材料コストの削減、基板容量の縮小を達成すること。

【解決手段】 マザーボードプリント配線板10に、予め外形加工がなされた少なくとも1枚の配線回路付き基材21が貼り合わせされており、それらが少なくとも1箇所でインナビアホール24によって電気的に接続されている。配線回路付き基材21の外形はマザーボードプリント配線板10の外形より小さく、配線回路付き基材21がマザーボードプリント配線板10上で島状をなしている。

【選択図】 図1

特願2003-011635

出願人履歴情報

識別番号 [000005186]

1. 変更年月日 1990年 8月16日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都江東区木場1丁目5番1号  
氏 名 藤倉電線株式会社

2. 変更年月日 1992年10月 2日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都江東区木場1丁目5番1号  
氏 名 株式会社フジクラ